HUWIN

Tips & Solution Seminar :

ANSYS Electronic를 이용한 High speed Interface 설계 최적화



정종혁, jjh@huwin.co.kr , 010-9108-5440

2023. 6. 23

Contents:



Slwave region을 이용한 해석 사례 및 주의 사항

■ <u>개요</u>

- ✤ 고속 전송 채널은 점점 복잡해지고 작아지기 때문에 상호 영향성이 커지고 제조/조립 후 수정이 어렵기 때문에 해석을 이용한 설계의 필요성이 높아짐
- ◆ Slwave는 hybrid 2.5D 해석 방식으로 해석 속도가 빠르고 고속 신호 PCB 설계의 필수
 - ▶ Signal integrity & resonance 분석: PCB 해석 기본 기능
 - ▶ Power integrity & DC IR drop 분석: 고속 신호 IC 동작을 위한 기본 조건, SI보다 먼저 필요
 - ➢ Decoupling capacitor 최적화
- ✤ HFSS는 3D full wave 해석 결과가 정확하지만 많은 리소스가 필요
- ✤ 해석 개체에 따라 적절한 선택이 필요



■ <u>개요</u>

- ◆ 효율적인 PCB 해석을 위해 HFSS를 이용하여 Slwave와 연동 해석 솔루션을 제공함
- ✤ Slwave의 Region으로 설정한 구간은 HFSS 3D layout로 해석하고 나머지 구간만 Slwave로 해석
- ✤ HFSS 3D layout는 같은 layer를 2D로 형성하고 Z축 sweep하는 phi mesh 기능을 이용하여 HFSS 대비 initial mesh 생성속도가 매우 빠름



HUWIN

■ <u>HFSS region in Slwave – 설정 방법 및 동작 원리</u>

- ✤ PCB 복잡도에 따른 선택: 단순 구간은 Slwave로 해석 하고, 복잡한 주요 구간은 HFSS로 해석하여 정확한 결과를 빠르게 얻을 수 있음
- ✤ HFSS region으로 설정된 구간은 전체 PCB 환경과 동일한 조건으로 해석되도록 주의하여 설정 필요
- ✤ BGA, Via 등의 복잡한 구간의 임피던스 불연속과 공진이 발생하는 경우가 많고 그에 의한 영향이 채널 특성 저하의 주요한 원인이 되는 경우가 많음



HUWIN

■ <u>HFSS region in SIwave - 결과 비교</u>

- ✤ 복잡한 구조의 BGA 부분 오차가 큼
- ◆ 단순한 구조의 diff. line 부분 오자가 적음







HUWIN

■ <u>HFSS region in Slwave – TDR 결과 비교</u>

- TDR의 Rise time이 작아질수록 BGA 부분 결과 차이가 큼 **
- 결과 차이의 정도는 PCB 형상에 따라 다름 *





HUWIN

■ <u>HFSS region in SIwave - EYE 결과 비교</u>

◆ 고속 신호의 경우 HFSS와 Slwave 해석 결과이 차이가 큼





Contents:

Slwave & HFSS 3d layout 연동 해석 소개

Slwave region을 이용한 해석 사례 및 주의 사항

■ <u>HFSS region in SIwave – 해석 사례 #1</u>

✔ Region에 의해 자동으로 생성되는 port 설정
✔ 설정된 region 경계면에 port가 자동으로 생성되기 때문에 split 구간에 위치 하지 않도록 주의



HUWIN

HUWIN

■ <u>HFSS region in SIwave - 해석 사례 #1</u>

- ✤ Port reference layer에 따른 결과 차이
 - ▶ 전체를 HFSS로 해석한 결과(빨간)와 비교하여 정상적인 region 설정 결과(검정)는 매우 유사함
 - ▶ 잘못된 region 설정 결과(파란)는 오차가 매우 큼



■ <u>HFSS region in SIwave – 해석 사례 #2</u>

✤ Region 설정으로 자동 생성된 HFSS와 Slwave 형상



HUWIN

HFSS region in Slwave – 해석 사례 #2

- ◆ 해석 결과 비교
 - ▶ HFSS(빨간색)와 Slwave 해석 결과(녹색) 22.8, 45.8GHz 공진 발생
 - ▶ Region 해석 결과(파란색) 32.9GHz 추가 공진 발생



HUWIN

 \times

Im. Fr

0.073

0.149

0.228

Comput

Reference L

GND 2

GND_2

Close





**

HUWIN

89

Mode

Mode

2

2

Re. Freq (GHz)

32.300704527

71.180512209

Plot Layer

TOP 1

TOP 1

Plot voltage difference between planes on

TOP_1 v and GND_2 v Comp

GND 2

GND_2

Phase Animation.

Reference Layer

Close

Im. Freq (GHz)

0.097441278

0.228475823

HFSS region in Slwave - 해석 사례 #2 +1 V HR0 구간 공진 분석 결과 +8.571E-01 V ▶ Slwave 32.6GHz에서 공진 +7.143E-01 \ HFSS: 32.9GHz 공진 \triangleright +5.714E-01 \ S-parameters Ansys +4.286E-01 \ 0.00 +2.857E-01 V Slwave 해석 결과 +1.429E-01 -1.25 +0 V Name X [GHz] Υ -2.50 Щ m1 32.6000 -8.6041 Magnitude in -3.75 -1.429E-01 V -2.857E-01 V -4.286E-01 V -6.25 -5.714E-01 V S(trace1,trace_1) -7.50 SYZ Sweep HR0 S Plot -7.143E-01 V -8.75 -8.571E-01 V 0 10 20 30 40 50 0 mm Frequency [GHz] -1 V Circuit1 Ansys RL & IL HR0 -2 dB(S(trace1,trace_1)) -4 -6 Name X [GHz] Y m1 m1 32.90 -6.83 -8 dB(S(trace1,trace 1)) HFSS 해석 결과 dB(S(trace_1,trace_1)) -10 ò 10 20 30 40 50 Freq [GHz]

HFSS region in Slwave – 해석 사례 #3

- ◆ Region이 power plane 일부를 포함하고 주변 via를 충분히 포함하지 않은 경우
 - ▶ De-cap을 포함하지 못한 power plane은 region 설정은 공진의 원인이 됨
 - 실계된 PCB는 cap 또는 power IC 등의 소자와 연결되어 임피던스가 낮기 때문에 SI 해석 환 경도 동일하게 유지해야 함
 - ▶ 시뮬레이션 뿐만 아니라 실측을 하는 경우에도 power plane이 open 상태가 되지 않도록 주 의가 필요



HFSS region in Slwave – 해석 사례 #3

✤ 해석 결과 비교

0.0

-12.5

-25.0

∑ -37.5

-50.0

-62.5

-75.0 -

0

10

- ▶ power plane은 open 상태로 생성
- ▶ ground plane은 연결되지 않게 생성

Return loss Case3

20

Freq [GHz]



HUWIN

Pads to Plan

HFSS region in Slwave – 해석 사례 #4

- ✤ Trace로 import 된 antipad & reference plane
 - ▶ layer03에 signal trace로 구성된 4층 PCB의 layer02의 via antipad와 reference plane이 trace 로 import 된 경우

Boolean Convert

▶ Slwave의 개체 속성을 plane으로 변경 필요



■ <u>HFSS region in SIwave - 해석 사례 #4</u>

- ◆ 각각 trace와 plane으로 지정하여 해석한 결과 비교
 - ▶ Return loss는 trace와 plane의 결과가 유사함
 - ▶ Insertion loss는 plane의 결과가 HFSS의 결과와 유사함
 - ▶ HFSS는 개체 종류를 구분하지만 해석 결과는 동일함





<u> 커넥터 HFSS 3D 해석 필요성</u>

- ◆ 커넥터와 PCB가 조립되는 pad 부분은 일반적인 trace보다 넓은 폭을 갖는 패드 부분이 필요
- ◆ 터미널을 포함한 도체 두께가 있으므로 이로 임피던스가 낮아짐
- ◆ 소형화된 커넥터는 패드 뿐만 아니라 인접한 trace와 간섭이 발생
- ◆ 제조사 제공 커넥터 S-parameter는 PCB 패드 등이 최적화 됨
- ◆ 주로 내부 터미널 형상이 암호화 된 모델이 제공됨



터미널 형상

납 형상

HUWIN

<u> 커넥터 HFSS 3D 해석 필요성</u>

✤ Slwave PCB와 커넥터 포함한 HFSS 비교



HUWIN

Q&A

감사합니다.